

L'avènement des interconnexions en cuivre

Par *admin*

Créé le 07/06/1998 - 23:00

L'avènement des interconnexions en cuivre

Dimanche, 07/06/1998 - 22:00 [0 commentaire](#)

- [Diminuer la police](#)
- [Augmenter la police](#)
- [Imprimer](#)
- [Version PDF](#)

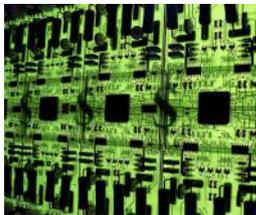
•

- [Tweeter](#)

•

•

0 avis :



[zoom](#)

La question n'est pas de savoir si le cuivre va remplacer l'aluminium. La question est quand et comment ". Le point de vue de Peter Hantley dirigeant de Novellus, résume bien l'état d'esprit de l'industrie du semi-conducteur. Les performances des interconnexions en aluminium utilisées actuellement sont insuffisantes, et l'introduction d'un nouveau métal de résistance électrique moindre est donc indispensable. Ceci permettra d'augmenter le flux électrique en même temps que la puissance de calcul des circuits intégrés. Un équipementier américain, Novellus, pourrait bien avoir pris de l'avance sur ses concurrents : il a dévoilé une gamme complète d'équipements associés à la technologie cuivrée, baptisée " Damascus.

(OTEC)

Noter cet article :

Recommander cet article :

•

- [Tweeter](#)

•

- **Nombre de consultations** : 78
- **Publié dans** : [Electronique](#)
- **Partager** :
 - [Facebook](#)
 - [Viadeo](#)
 - [Twitter](#)
 - [Wikio](#)

[Electronique](#)

URL source: <https://www.rtflash.fr/l-avenement-interconnexions-en-cuivre/article>